

<日本特許・実用新案明細書収録セット>

ホームページ公開中! <http://www.itdc-patent.com>

*最新の特許情報が満載!

無電解ニッケル合金メッキ方法

[公開編]平成15年~平成19年(5年間) 67点

(税込価格)

(本体価格)

全文PDF	CD-ROM 版(抄録版付)	¥28,140-	¥26,800-
全文紙収録	B5製本版	¥28,140-	¥26,800-
(CD-ROM版・B5製本版 一括購入)		¥42,000-	¥40,000-

既刊関連セットのご案内

(本体価格)

No.10199	公開特許	無電解スズ合金メッキ方法と浴の組成	平.13-17	62点	¥25,000
No.9998	"	スズ合金メッキ方法と浴の組成	平.13-17	100点	¥29,600
No.9189	"	"	平.10-12	68点	¥24,800
No.8533	"	"	平.7-9	67点	¥26,700
No.7798(B)	"	"	平.3-6	51点	¥19,800
No. "(A)	"	"	昭.62-平.2	46点	¥17,900
No.10153	"	バレルメッキ方法と装置	平.17-18	82点	¥24,600
No.9798	"	"	平.15-16	74点	¥19,700
No.9463	"	"	平.13-14	70点	¥16,100
No.9069	登録・公開	"	平.11-12	68点	¥26,600
No.8579	"	"	平.9-10	76点	¥30,000
No.8084	公告・公開	"	平.7-8	73点	¥29,700
No.7797	"	"	平.5-6	66点	¥23,000
No.7558	"	"	平.3-4	109点	¥39,200
No.10054	公開特許	電気めっき用治具とめっき方法	平.17-18	68点	¥23,800
No.9797	"	"	平.15-16	68点	¥18,400
No.9464	"	"	平.13-14	68点	¥16,100
No.9241	"	"	平.11-12	67点	¥20,000
No.8641(B)	"	"	平.8-10	90点	¥31,000
No. "(A)	"	"	平.5-7	91点	¥31,300
No.9088	"	硫酸銅メッキ方法と浴の組成	平.5-12	71点	¥27,400

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、EメールまたはFAX・郵便にてお送りください。

(メール宛先: kokusai@itdc-patent.com お電話でも承ります)

[CD-ROM版はPDFファイルにしておりリンク機能、B5製本版はB5サイズ・目次製本済みです。

2~3日中に請求書同封の上お送り致します。]

お 申 込 書

会社名	ご注文内容
	ニュースガイド No. , CD-ROM版・B5製本版・一括購入
所属部署	題 名
	合計 ¥
担当者名	E-mail
	() Fax ()
住所 〒	

無電解ニッケル合金メッキ方法

No. 10223

[公開編] 平成15年～平成19年(5年間) 67点

CD-ROM版 ¥28,140

B5製本版 ¥28,140

(全て税込価格)

(CD-ROM版・B5製本版 一括購入 ¥42,000)

1	金属 - セラミックス接合基板の製造方法	同和鉱業株式会社	34	めっき方法、及び電子部品の製造方法	株式会社村田製作所
2	無電解めっき方法及び装置	株式会社荏原製作所	35	半導体装置及びその製造方法	株式会社荏原製作所
3	半導体装置及びその製造方法	株式会社荏原製作所	36	黒色膜付基材の製造方法および黒色膜付基材	昭和電工株式会社
4	半導体装置及びその製造方法	ソニー株式会社	37	めっき浴を保全する方法	エンソーインコーポレイテッド
5	半導体装置及びその製造方法	ソニー株式会社	38	金属 - セラミックス接合部材およびその製造方法	同和鉱業株式会社
6	半導体装置の製造方法	ソニー株式会社	39	金属 - セラミックス回路基板およびその製造方法	同和鉱業株式会社
7	電子部品の製造方法、及び電子部品	株式会社村田製作所	40	基板処理方法及び基板処理装置	株式会社荏原製作所
8	電子部品の製造方法、及び電子部品	株式会社村田製作所	41	無電解ニッケルめっき浴および無電解ニッケル合金めっき浴	荏原ユーザライト株式会社
9	無電解めっきの前処理方法及び前処理液	株式会社荏原製作所	42	無電解ニッケルめっき浴及び無電解ニッケル合金めっき浴	荏原ユーザライト株式会社
10	電鍍加工によるゲートブッシュ製造方法	シェル工業株式会社	43	無電解ニッケルめっき液の寿命延長方法、及び無電解ニッケルめっき液	日本碍子株式会社
11	電子部品の製造方法、及び電子部品めっき方法、めっき装置、半導体装置の製造方法及び半導体装置の製造装置	株式会社村田製作所	44	フレキシブルプリント基板の製法	東海ゴム工業株式会社
12	無電解めっき方法及び無電解めっき装置	ソニー株式会社	45	無電解ニッケルめっき浴および磁気ディスク用基板ならびに磁気ディスク	東洋鋼鈹株式会社
13	電子写真装置の加熱ローラおよびその製造方法	東北リコー株式会社	46	配線形成方法及び配線形成装置	株式会社荏原製作所
14	金属基体に亀甲状色彩効果を与える為の方法	ファブリカ ダルミ ピエトロ ベレッタ ソチエタ ペル アチオニ	47	樹脂製軸受部品とその製造方法	株式会社アクトワン
15	めっき前処理法及びめっき皮膜を有する複合材	同和鉱業株式会社	48	金属 - セラミックス接合基板の製造方法	同和鉱業株式会社
16	半導体装置の製造方法及び製造装置	ソニー株式会社	49	リン酸塩被膜を有する無電解ニッケルめっき膜の形成方法およびその形成膜	日本カニゼン株式会社
17	半導体装置の製造方法	ソニー株式会社	50	機能性粒子及びその製造方法	日立マクセル株式会社
18	基板の製造方法	株式会社村田製作所	51	めっき部材	東陶機器株式会社
19	無電解めっき装置および無電解めっき後の洗浄方法	株式会社荏原製作所	52	表面処理Al板	東洋鋼鈹株式会社
20	電子部品の製造方法、及び電子部品	株式会社村田製作所	53	構造体の製造方法	キヤノン株式会社
21	半導体装置およびその製造方法	ソニー株式会社	54	機能性粒子及びその製造方法	日立マクセル株式会社
22	フレキシブルプリント基板の製法	東海ゴム工業株式会社	55	無電解ニッケル複合めっき浴および無電解ニッケル合金複合めっき浴	荏原ユーザライト株式会社
23	半導体装置の製造方法および半導体製造装置	ソニー株式会社	56	配線用フィルム基板の製造方法、製造装置および配線用フィルム基板	日立マクセル株式会社
24	半導体装置の製造方法および半導体製造装置	ソニー株式会社	57	他物体との接触摩擦により表面が摩耗することを考慮した物品	株式会社東電工舎
25	半導体装置の製造方法	ソニー株式会社	58	耐摩耗性部材および動力伝達部品	株式会社神戸製鋼所
26	めっき方法およびめっき装置	株式会社荏原製作所	59	耐摩耗性チタン材	株式会社神戸製鋼所
27	リチウム電池負極用材料及びその製造方法	株式会社神戸製鋼所	60	無電解ニッケルめっき浴およびそれを用いた無電解めっき方法	松下電器産業株式会社
28	無電解めっき方法	日立化成工業株式会社	61	無電解ニッケルめっき用前処理液、無電解ニッケルめっきの前処理方法無電解ニッケルめっき方法、並びに、プリント配線板及び半導体チップ搭載用基板の製造方法	日立化成工業株式会社
29	基板処理方法及び基板処理装置	株式会社荏原製作所			
30	耐食性材料およびその製造方法	昭和電工株式会社			
31	鉛を含まない化学的ニッケル合金	アーハーツェー オーバーフレヒエンテヒニーク ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフト ウント コ			
32	めっき方法及びめっき装置	株式会社荏原製作所			
33					

以下6点省略